

반도체장학사업 안내 자료



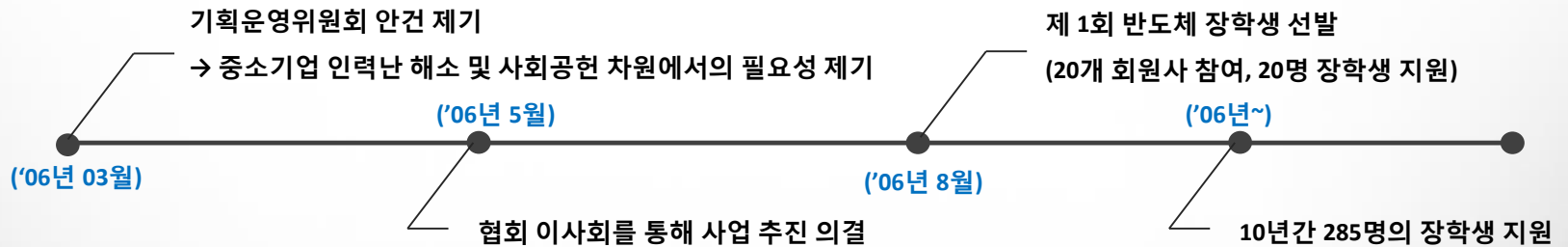
2016. 06. 17

사업 개요

사업 목적

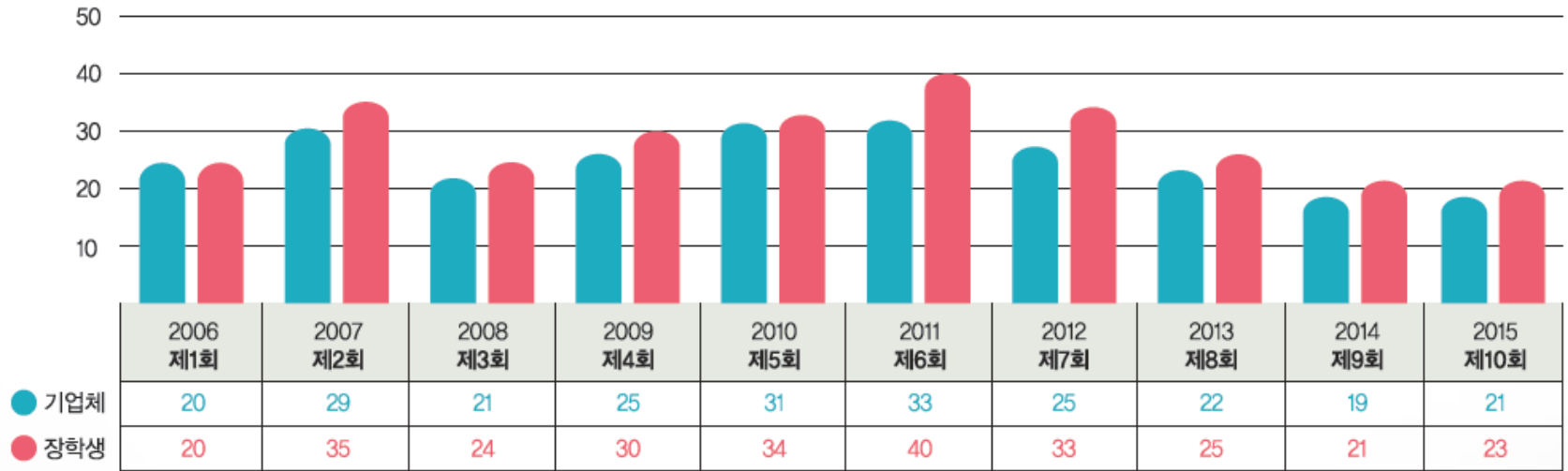
- **(우수 인재 발굴 및 양성 지원)** 반도체산업은 창의적 인재를 기반으로 하는 첨단산업임에도 불구하고 지속적인 인력난으로 인해 인력수급의 어려움이 심각한 상황으로 우수 인재 유치 및 지원 필요
- **(개별 기업 홍보 지원)** 장학생 추천, 선발 등의 과정을 통한 대학(원) 내 기업 홍보 및 장학생 대면식, 장학 증서 수여식 개최 등을 통해 개별 기업의 사회 공헌 활동 홍보 지원
- **(반도체 산업 이미지 제고)** 국내 수출품목 1위이자 국가 주력산업이라는 위상에 맞게 산업계가 먼저 나서 미래 인재 양성을 적극 지원하는 모습을 대내외적으로 보임으로서 산업 이미지 제고

추진 배경 및 연혁



추진 실적

■ 지난 10년간 총 61개사에서 285명의 장학생 지원



참여 기업 LIST

(주)국제일렉트릭코리아(주)
 (주)글로벌스탠다드테크놀로지
 네오피델리티(주)
 (주)뉴파워프라즈마
 도쿄일렉트론코리아(주)
 (주)동부하이텍
 동우화인켐(주)
 (주)동진세미켐
 (주)디아이
 (주)디아이세미콘
 랠리서치코리아
 삼성전자(주)

(주)삼우이엔씨
 성원에드워드(주)
 세메스(주)
 (주)신성이엔지
 (주)실리콘마이터스
 (주)실리콘웍스
 (주)실리콘화일
 싸이머코리아(주)
 (주)씨앤에스테크놀로지
 아드반테스트코리아(주)
 (주)아이앤씨테크놀로지
 (주)아이피에스

(주)아토
 (주)애플피에스
 엠코테크놀로지코리아(주)
 어플라이드머티어리얼즈코리아(주)
 에드워드코리아
 에스티아이
 에어프로덕츠코리아(주)
 에이에스엠엘코리아(주)
 (주)에프에스티
 (주)엑시콘
 (주)엘오티베콤
 (주)엘지실트론

엠이엠씨코리아(주)
 엠텍비전(주)
 (주)원익머트리얼즈
 (주)원익아이피에스
 (주)이오테크닉스
 (주)자람테크놀로지
 (주)제이티
 (주)지씨티리써치
 참엔지니어링(주)
 (주)카이로넷
 (주)케이씨텍
 (주)코미코

(주)코아로직
 토판포토마스크(주)
 (주)테스
 (주)티엘아이
 (주)파이컴
 피에스케이(주)
 (주)피케이엘
 한국베리안(주)
 한미반도체(주)
 한양이엔지(주)
 GST
 LG전자(주)
 SK하이닉스(주)

사진 자료



장학생 대상 및 지원 사항

장학 대상자

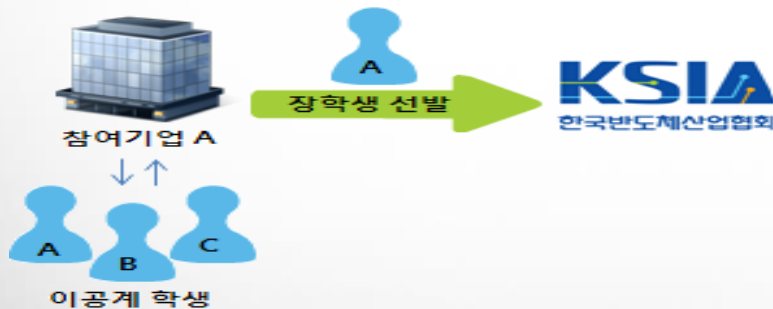
- 대학 4학년 또는 대학원 2년차 진학 예정자로 반도체 관련 분야 이공계 학생
- 장학사업 Follow-up 서비스 참여가 가능한 학생(취업 여부 확인 설문조사 등)
- 동일 학기 중 타 장학금과 이중수혜 불가
- 기타 참여기업이 제시하는 조건(예, 장애학우, 여학생, 학점 4.0이상 등)

<우선 선발 대상자>

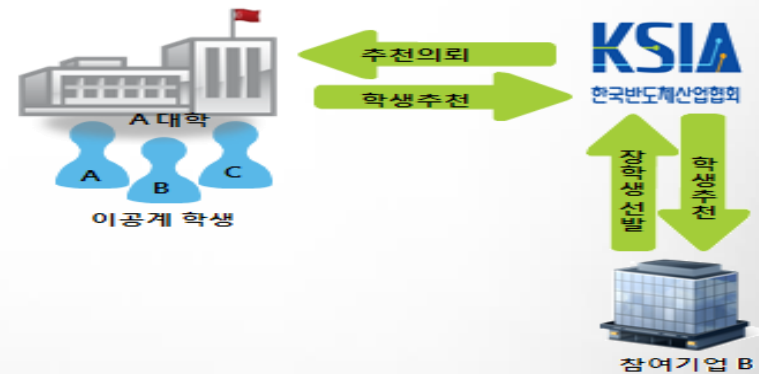
- 반도체관련 과목 성적 우수자 및 교과목 이수자(평균 평점 B+ 학점 이상인 자)
- 반도체관련 공모전 입상자 또는 반도체 기업 인턴 참여 학생에게는 가산점 부여
- 졸업 후 반도체기업 입사 희망자

장학생 선발

① 기업 자체 선정



② 협회 추천 선정(단, 기업이 특정 대학, 학과 지정)



장학금 출연 및 장학증서 수여식

장학금 출연

- 장학금 출연 금액 : **1계좌당 1,000만원**(참여 기업당 1계좌 이상 출연)
- **기부금 영수증** 발급 가능(대학 → 기업)
- 장학금 명칭은 '**반도체 장학금**' 으로 통칭하되, **Sub Title**은 참여 기업명을 따름(기업 홍보 지원)
(예시) SK하이닉스 장학금, 삼성전자 장학금, 세메스 장학금, FST 장학금 등

반도체 장학증서 수여식(안)

- 일 시 : 2016. 10. 27(목) 17:00~18:00
- 장 소 : 코엑스인터콘티넨탈 호텔
- 참석자 : 참여 기업 대표이사 및 인사담당자, 장학생 등 약 80여 명 참석
- 내 용 : **반도체 장학생 대면식 및 장학증서 전달**
 - 장학생과 참여 기업간의 만남을 통해 기업과의 연대감 및 소속감 고취
 - 우수 인재가 반도체 산업계로 진입할 수 있도록 반도체산업 및 기업에 대한 긍정적 인식 제고



'16년 추진 일정

참여 희망 기업 수요조사

- 반도체장학사업 참여 의향서 접수 (기업 → 협회)
 - 장학생 선발 방식 선택
 - 희망 대학(원), 학과(전공) 등 통보
 - 계좌수(1계좌 : 1,000만원) 확정 (학생당 1,000만원 지원)

6.17 ~ 7.8

장학생 선발 및 확정

- '기업 자체 선정'(기업→협회)
 - 기업 자체 면접 등 기업 내부 절차
- '협회 추천 선정'(협회→기업→협회)
 - 협회 추천 후보 학생 중 기업 선정

7.11 ~ 10.7

반도체 장학생 대면식 및 장학증서 수여식

- "제 9회 반도체의 날" 연계
 - 일 시 : 10. 27(목) 예정
 - 장 소 : 코엑스 인터컨티넨탈호텔
 - 참석자 : 참여기업 대표이사 및 인사담당자
반도체 장학생 등 80여 명

10.27(THU)

'17. 2 ~ 9

장학생 추천 의뢰

- 협회 추천 선정의 경우, 기업이 지정한 대학, 학과 등에 장학생 추천 의뢰(협회 → 대학)
- 기업이 원하는 자격조건에 따라 장학생 후보 복수로 추천받아 전달

기업별 장학금 출연

- 장학금 출연 금액을 각 대학에 입금 (기업 → 대학)
- 입금 확인 후, 기부금 영수증 발급 (대학 → 기업)
 - 협회는 영수증 발급 업무 지원

장학금 지급

- 등록기간에 맞춰 장학금 지급 (대학 → 학생)
 - 1,000만원/학생당
 - 1회 지급 or 학기별 분할 지급 가능